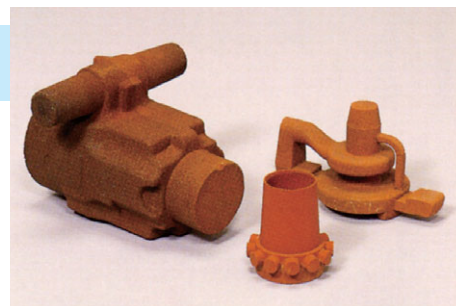


13

鋳物用

シェルモールド用、常温自硬化性用に特徴のある樹脂を用意しております。



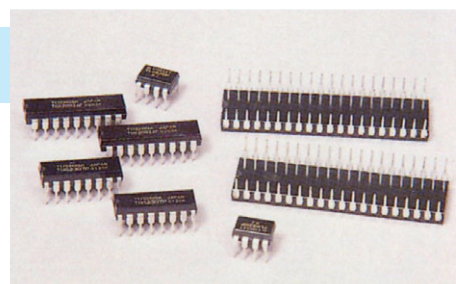
品名	用途・特長	樹脂の特性	
		プレート・70-(mm)	融点(°C)
BRP-510	塗型用 分散性良好 ノボラック・ヘキサ	15 — 35	80 — 90

品名	用途・特長	樹脂の特性	
		粘度(mPa·s)	不揮発分(%)
BRL-211J	鋳物用 レゾール	100 — 150	65 — 69
ARL-005	硬化剤	10 — 20	40 — 50

14

半導体封止材用

フリーフェノール、金属、ハロゲン元素等の不純物を徹底的に除去したノボラック型フェノール樹脂でエポキシと組み合わせ半導体・封止材の分野に使用されています。



品名	形状	用途・特長	樹脂の特性	
			熔融粘度(Pa·s/°C)	軟化点(°C)
BRG-555	マーブル	電子材料用 高純度ノボラック フリーフェノール含有量(%)≒0	0.3 — 0.5/125	66 — 72
BRG-556			0.1 — 0.3/150	77 — 83
BRG-557			0.2 — 0.4/150	82 — 88
BRG-558			0.8 — 1.2/150	93 — 98
CRG-951			0.2 — 0.8/150	93 — 99
TAM-005	塊状		0.3 — 0.5/150	80 — 88